

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



香港聯交所股票代號：1347

## 新聞稿

# 華虹半導體二零二一年第三季度業績公佈

*所有貨幣以美元列帳，除非特別指明。*

*本合併財務報告系依香港財務報告準則編製。*

中國香港 — 2021年11月11日 — 全球領先的特色工藝純晶圓代工廠華虹半導體有限公司（香港聯交所股票代號：1347）（「本公司」）於今日公佈截至二零二一年九月三十日止三個月的綜合經營業績。

### 二零二一年第三季度主要財務指標（未經審核）

- 銷售收入再創歷史新高，達 4.515 億美元，同比上升 78.5%，環比上升 30.4%。
- 毛利率 27.1%，同比上升 2.9 個百分點，環比上升 2.3 個百分點。
- 期內溢利 3,560 萬美元，同比上升 3,132.1%，環比下降 4.2%，主要由於一項一次性公司間交易致所得稅開支增加。
- 母公司擁有人應佔溢利 5,080 萬美元，同比上升 187.1%，環比上升 15.3%。
- 基本每股盈利 0.039 美元，同比上升 0.025 美元，環比上升 0.005 美元。
- 淨資產收益率（年化）7.6%，同比上升 4.4 個百分點，環比上升 0.8 個百分點。

### 二零二一年第四季度指引

- 我們預計銷售收入約 4.90 億美元左右。
- 我們預計毛利率約在 27%至 28%之間。

## 總裁致辭

本公司總裁兼執行董事唐均君先生，對第三季度的業績評論道：

“2021 年第三季度是公司歷史上表現最為強勁的一個季度！幾乎所有細分市場都有強勁的需求，尤其是 MCU、電源管理、IGBT、超級結、CIS 和邏輯及射頻。銷售收入再度創出歷史新高，達到 4.515 億美元，同比增長 78.5%，環比增長 30.4%。毛利率持續保持穩定，並上升到了 27.1%，同比上升 2.9 個百分點，環比上升 2.3 個百分點。如此卓越的表現主要歸功於各主要技術平臺產品平均銷售價格的提升和極高的產能利用率。感謝華虹半導體所有員工的全心奉獻和不懈努力，使得我們的銷售收入和毛利率再一次雙雙超越指引。”

唐先生繼續說道，“我們對公司的未來充滿信心。從目前的市場需求來看，我們預計公司將迎來前所未有的機遇和成長，不僅 2021 年必將迎來公司有史以來最高的銷售額、最大的成長幅度，而且將在 2022 年繼續迅速成長、續寫輝煌篇章！因此，我們正在全速推進無錫工廠的下一步擴產，計畫在明年年底可以達到 9.5 萬片的 12 英寸月產能，從而更好地滿足客戶對我們的需求和期待。再下一步的擴產方案也在規劃過程中，我們將在完成內部評估後對外宣佈。”

## 電話會議公告

日期：二零二一年十一月十一日（星期四）

時間：16:00（香港/上海時間）  
03:00（美國東部時間）

發言人：唐均君，總裁兼執行董事  
王鼎，執行副總裁兼首席財務官

廣播：該電話會議將於下述網站進行語音及幻燈片直播：

[http://www.huahonggrace.com/c/investor\\_webcast.php](http://www.huahonggrace.com/c/investor_webcast.php) 或

<https://edge.media-server.com/mmc/p/47bntgv4>

(注：需要註冊才能訪問網絡直播)

電話直撥：請在會議前使用以下連結先進行註冊。註冊後，您將收到確認郵件獲得撥入號碼、密碼和唯一的註冊人 ID。

<http://apac.directeventreg.com/registration/event/9083522>

**重要提示：**在會議開始前，您需要使用確認郵件中提供的密碼和註冊人 ID 才能進入會議。請在註冊後，注意查收並保存確認郵件。出於安全原因，請不要與任何人共用您的註冊人 ID。

電話會議登入名：9083522

直播約 24 小時後，您可於 12 個月內在 [http://www.huahonggrace.com/s/investor\\_webcast.php](http://www.huahonggrace.com/s/investor_webcast.php) 網頁上，重複收聽會議。

## 關於華虹半導體

華虹半導體有限公司（「華虹半導體」，股份代號：1347.HK）（「本公司」）是全球領先的特色工藝純晶圓代工企業，專注於嵌入式非易失性存儲器、功率器件、模擬及電源管理和邏輯及射頻等「8 英寸 + 12 英寸」特色工藝技術的持續創新，先進「特色 IC + Power Discrete」強大的工藝技術平台有力支持物聯網等新興領域應用，其卓越的質量管理體系亦滿足汽車電子芯片生產的嚴苛要求。本公司是華虹集團的一員，而華虹集團是以集成電路製造為主業，擁有「8 英寸 + 12 英寸」生產線先進工藝技術的企業集團。

本公司在上海金橋和張江建有三座 8 英寸晶圓廠（華虹一廠、二廠及三廠），月產能約 18 萬片。同時在無錫高新技術產業開發區內有一座月產能 4.8 萬片的 12 英寸晶圓廠（華虹七廠），不僅是中國大陸領先的 12 英寸特色工藝生產線，亦為全球第一條 12 英寸功率器件代工生產線。

如欲取得更多公司相關資料，請瀏覽：[www.huahonggrace.com](http://www.huahonggrace.com)。

**經營業績概要**  
(以千美元計，每股盈利和營運數據除外)

	二零二一年 第三季度 (未經審核)	二零二零年 第三季度 (未經審核)	二零二一年 第二季度 (未經審核)	同比	環比
銷售收入	451,484	252,981	346,110	78.5 %	30.4 %
銷售成本	(329,231)	(191,689)	(260,440)	71.8 %	26.4 %
<b>毛利</b>	<b>122,253</b>	<b>61,292</b>	<b>85,670</b>	<b>99.5 %</b>	<b>42.7 %</b>
<b>毛利率</b>	<b>27.1 %</b>	<b>24.2 %</b>	<b>24.8 %</b>	<b>2.9</b>	<b>2.3</b>
經營開支	(72,320)	(74,200)	(45,905)	(2.5)%	57.5 %
其他收入淨額	7,486	24,056	11,896	(68.9)%	(37.1)%
<b>稅前溢利</b>	<b>57,419</b>	<b>11,148</b>	<b>51,661</b>	<b>415.1 %</b>	<b>11.1 %</b>
所得稅開支	(21,801)	(10,046)	(14,483)	117.0 %	50.5 %
<b>期內溢利</b>	<b>35,618</b>	<b>1,102</b>	<b>37,178</b>	<b>3,132.1 %</b>	<b>(4.2)%</b>
<b>淨利潤率</b>	<b>7.9 %</b>	<b>0.4 %</b>	<b>10.7 %</b>	<b>7.5</b>	<b>(2.8)</b>
以下各方應佔利潤：					
母公司擁有人	50,807	17,694	44,082	187.1 %	15.3 %
非控股權益	(15,189)	(16,592)	(6,904)	(8.5)%	120.0 %
持有人應佔每股盈利					
基本	0.039	0.014	0.034	178.6 %	14.7 %
攤薄	0.038	0.013	0.033	192.3 %	15.2 %
付運晶圓(折合 8 吋矽片)	907	577	730	57.2 %	24.2 %
產能利用率 <sup>1</sup>	110.9 %	95.8 %	109.5 %	15.1	1.4
淨資產收益率 <sup>2</sup>	7.6 %	3.2 %	6.8 %	4.4	0.8

### 二零二一年第三季度

- 銷售收入再創歷史新高，達 4.515 億美元，同比上升 78.5%，環比上升 30.4%。
- 銷售成本 3.292 億美元，同比上升 71.8%，環比上升 26.4%，主要由於晶圓銷售量及折舊成本上升。
- 毛利率 27.1%，同比上升 2.9 個百分點，環比上升 2.3 個百分點，主要得益於平均銷售價格上漲，部分被折舊成本上升所抵消。
- 經營開支 7,230 萬美元，同比下降 2.5%。經營開支環比上升 57.5%，主要由於人員開支增加及研發活動的政府補助減少。
- 其他收入淨額 750 萬美元，同比下降 68.9%，主要由於本季度為外幣匯兌損失，而上年同期為外幣匯兌收益，分佔聯營公司溢利、政府補貼減少，及財務費用增加所致，環比下降 37.1%，主要由於本季度為外幣匯兌損失而上季度為外幣匯兌收益，部分被政府補貼增加所抵消。
- 所得稅開支 2,180 萬美元，同比上升 117.0%，環比上升 50.5%，主要由於應課稅利潤增加，包括一項公司間技術轉授權交易 4,570 萬美元。
- 期內溢利 3,560 萬美元，同比上升 3,132.1%，環比下降 4.2%，主要由於一項一次性公司間交易致所得稅開支增加。
- 母公司擁有人應佔溢利 5,080 萬美元，同比上升 187.1%，環比上升 15.3%。
- 基本每股盈利 0.039 美元，同比上升 0.025 美元，環比上升 0.005 美元。
- 淨資產收益率（年化）7.6%，同比上升 4.4 個百分點，環比上升 0.8 個百分點。

<sup>1</sup>產能利用率按平均月約當產量除以總估計月產能計算。

<sup>2</sup>母公司擁有人應佔利潤 / 加權平均母公司擁有人應佔淨資產。

分部經營業績<sup>3</sup>  
(以千美元計，營運數據除外)

	二零二一年 第三季度 (未經審核)	二零二零年 第三季度 (未經審核)	二零二一年 第二季度 (未經審核)	同比	環比
<b>華虹 8 吋</b>					
銷售收入	314,784	236,378	261,975	33.2 %	20.2 %
毛利	110,696	64,278	82,862	72.2 %	33.6 %
毛利率	35.2 %	27.2 %	31.6 %	8.0	3.6
經營開支	(42,602)	(30,791)	(20,835)	38.4 %	104.5 %
稅前溢利	81,562	45,009	65,751	81.2 %	24.0 %
息稅折舊及攤銷前利潤	118,594	80,035	103,994	48.2 %	14.0 %
息稅折舊及攤銷前利潤率	37.7 %	33.9 %	39.7 %	3.8	(2.0)
付運晶圓(8 吋仔片)	622	537	546	15.8 %	13.9 %
<b>華虹無錫</b>					
銷售收入	136,700	16,603	84,135	723.3 %	62.5 %
毛利	11,557	(2,986)	2,808	(487.0)%	311.6 %
毛利率	8.5 %	(18.0)%	3.3 %	26.5	5.2
經營開支	(29,718)	(43,409)	(25,070)	(31.5)%	18.5 %
稅前溢利	(24,143)	(33,861)	(14,090)	(28.7)%	71.3 %
息稅折舊及攤銷前利潤	29,949	(11,517)	29,864	(360.0)%	0.3 %
息稅折舊及攤銷前利潤率	21.9 %	(69.4)%	35.5 %	91.3	(13.6)
付運晶圓(折合 8 吋仔片)	285	40	184	612.5 %	54.9 %

**華虹 8 吋**

- 銷售收入創歷史新高，達 3.148 億美元，同比上升 33.2%，環比上升 20.2%。
- 毛利率 35.2%，同比上升 8.0 個百分點，環比上升 3.6 個百分點，主要得益於平均銷售價格上漲。
- 經營開支 4,260 萬美元，同比上升 38.4%，環比上升 104.5%，主要由於研發開支及人員開支增加。
- 稅前溢利 8,160 萬美元，同比上升 81.2%，環比上升 24.0%。

**華虹無錫**

- 銷售收入 1.367 億美元，同比上升 723.3%，環比上升 62.5%。
- 毛利率 8.5%，環比上升 5.2 個百分點，主要得益於平均銷售價格上漲，部分被折舊成本增加所抵消。
- 經營開支 2,970 萬美元，同比下降 31.5%，主要由於研發工程片成本下降，部分被人員開支及服務費用上升所抵消，環比上升 18.5%，主要由於研發活動的政府補助減少。
- 息稅折舊及攤銷前利潤 2,990 萬美元，與上季度持平，主要由於毛利上升，部分被本季度為外幣匯兌損失而上季度為外幣匯兌收益，及人員開支上升所抵消。

<sup>3</sup>以上各分部的經營業績均為抵消分部間銷售後的數據。

### 銷售收入分析

按類別劃分的 銷售收入	二零二一年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零二一年 第三季度 % (未經審核)	二零二零年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零二零年 第三季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
晶圓	431,444	95.6 %	244,380	96.6 %	187,064	76.5 %
其他	20,040	4.4 %	8,601	3.4 %	11,439	133.0 %
<b>銷售收入總額</b>	<b>451,484</b>	<b>100.0 %</b>	<b>252,981</b>	<b>100.0 %</b>	<b>198,503</b>	<b>78.5 %</b>

- 本季度 95.6%的銷售收入來源於半導體晶圓的直接銷售。

### 銷售收入分析

按晶圓尺寸劃分的 銷售收入	二零二一年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零二一年 第三季度 % (未經審核)	二零二零年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零二零年 第三季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
8 吋晶圓	314,784	69.7 %	236,378	93.4 %	78,406	33.2 %
12 吋晶圓	136,700	30.3 %	16,603	6.6 %	120,097	723.3 %
<b>銷售收入總額</b>	<b>451,484</b>	<b>100.0 %</b>	<b>252,981</b>	<b>100.0 %</b>	<b>198,503</b>	<b>78.5 %</b>

- 本季度來自於 8 吋晶圓和 12 吋晶圓的銷售收入分別為 3.148 億美元及 1.367 億美元。

### 銷售收入分析

按地域劃分的 銷售收入	二零二一年	二零二一年	二零二零年	二零二零年	同比	同比
	第三季度	第三季度	第三季度	第三季度		
	仟美元	%	仟美元	%	仟美元	%
	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)		
中國 <sup>4</sup>	331,296	73.4 %	165,258	65.4 %	166,038	100.5 %
美國 <sup>5</sup>	47,924	10.6 %	34,144	13.5 %	13,780	40.4 %
亞洲 <sup>6</sup>	44,313	9.8 %	30,446	12.0 %	13,867	45.5 %
歐洲	20,897	4.6 %	16,444	6.5 %	4,453	27.1 %
日本 <sup>7</sup>	7,054	1.6 %	6,689	2.6 %	365	5.5 %
<b>銷售收入總額</b>	<b>451,484</b>	<b>100.0 %</b>	<b>252,981</b>	<b>100.0 %</b>	<b>198,503</b>	<b>78.5 %</b>

- 本季度來自於中國的銷售收入 3.313 億美元，占銷售收入總額的 73.4%，同比增長 100.5%，主要得益於各個技術平台產品的需求增加。
- 本季度來自於美國的銷售收入 4,790 萬美元，同比增長 40.4%，主要得益於其他電源管理及 MCU 產品的需求增加。
- 本季度來自於亞洲的銷售收入 4,430 萬美元，同比增長 45.5%，主要得益於 MCU、分立器件，和邏輯產品的需求增加。
- 本季度來自於歐洲的銷售收入 2,090 萬美元，同比增長 27.1%，主要得益於分立器件和智能卡芯片的需求增加。
- 本季度來自於日本的銷售收入 710 萬美元，同比基本持平。

<sup>4</sup>包括香港。

<sup>5</sup>包括於 2020 年由一家總部位於歐洲的公司所收購的一家主要美國客戶。

<sup>6</sup>不包括中國及日本。

<sup>7</sup>包括於 2013 年由一家總部位於美國的公司所收購的一家主要日本客戶。

### 銷售收入分析

按技術平台劃分的 銷售收入	二零二一年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零二一年 第三季度 % (未經審核)	二零二零年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零二零年 第三季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
嵌入式非易失性存儲器	126,514	28.0 %	87,396	34.6 %	39,118	44.8 %
獨立非易失性存儲器	19,889	4.4 %	2,796	1.1 %	17,093	611.3 %
分立器件	153,080	33.9 %	96,244	38.1 %	56,836	59.1 %
邏輯及射頻	80,079	17.7 %	32,661	12.9 %	47,418	145.2 %
模擬與電源管理	71,110	15.8 %	33,512	13.2 %	37,598	112.2 %
其他	812	0.2 %	372	0.1 %	440	118.3 %
<b>銷售收入總額</b>	<b>451,484</b>	<b>100.0 %</b>	<b>252,981</b>	<b>100.0 %</b>	<b>198,503</b>	<b>78.5 %</b>

- 本季度嵌入式非易失性存儲器銷售收入 1.265 億美元，同比增長 44.8%，主要得益於 MCU 和智能卡芯片的需求增加。
- 本季度獨立非易失性存儲器銷售收入 1,990 萬美元，同比增長 611.3%，主要得益於 NOR flash 產品的需求增加。
- 本季度分立器件銷售收入 1.531 億美元，同比增長 59.1%，主要得益於通用 MOSFET、超級結及 IGBT 產品的需求增加。
- 本季度邏輯及射頻銷售收入 8,010 萬美元，同比增長 145.2%，大部分得益於 CIS 和邏輯產品的需求增加。
- 本季度模擬與電源管理銷售收入 7,110 萬美元，同比增長 112.2%，主要得益於其他電源管理產品的需求增加。



### 銷售收入分析

按工藝技術節點劃分的銷售收入	二零二一年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零二一年 第三季度 % (未經審核)	二零二零年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零二零年 第三季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
55nm 及 65nm	40,109	8.9 %	593	0.2 %	39,516	6,663.7 %
90nm 及 95nm	82,470	18.3 %	22,910	9.1 %	59,560	260.0 %
0.11 $\mu$ m 及 0.13 $\mu$ m	83,789	18.6 %	60,268	23.8 %	23,521	39.0 %
0.15 $\mu$ m 及 0.18 $\mu$ m	46,165	10.2 %	37,576	14.9 %	8,589	22.9 %
0.25 $\mu$ m	7,040	1.6 %	4,951	2.0 %	2,089	42.2 %
0.35 $\mu$ m 及以上	191,911	42.4 %	126,683	50.0 %	65,228	51.5 %
<b>銷售收入總額</b>	<b>451,484</b>	<b>100.0 %</b>	<b>252,981</b>	<b>100.0 %</b>	<b>198,503</b>	<b>78.5 %</b>

- 本季度 55nm 及 65nm 工藝技術節點的銷售收入 4,010 萬美元，同比增長 6,663.7%，主要得益於 CIS、NOR flash 及邏輯產品的需求增加。
- 本季度 90nm 及 95nm 工藝技術節點的銷售收入 8,250 萬美元，同比增長 260.0%，主要得益於其他電源管理、智能卡芯片、CIS，及 MCU 產品的需求增加。
- 本季度 0.11 $\mu$ m 及 0.13 $\mu$ m 工藝技術節點的銷售收入 8,380 萬美元，同比增長 39.0%，主要得益於 MCU 和邏輯產品的需求增加。
- 本季度 0.15 $\mu$ m 及 0.18 $\mu$ m 工藝技術節點的銷售收入 4,620 萬美元，同比增長 22.9%，主要得益於邏輯及其他電源管理產品的需求增加。
- 本季度 0.25 $\mu$ m 工藝技術節點的銷售收入 700 萬美元，同比增長 42.2%，主要得益於邏輯產品的需求增加。
- 本季度 0.35 $\mu$ m 及以上工藝技術節點的銷售收入 1.919 億美元，同比增長 51.5%，主要得益於超級結、通用 MOSFET、IGBT，及其他電源管理產品的需求增加。

### 銷售收入分析

按終端市場分佈劃分的銷售收入	二零二一年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零二一年 第三季度 % (未經審核)	二零二零年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零二零年 第三季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
電子消費品	280,718	62.2 %	158,580	62.7 %	122,138	77.0 %
工業及汽車	90,176	20.0 %	50,355	19.9 %	39,821	79.1 %
通訊	66,418	14.7 %	34,833	13.8 %	31,585	90.7 %
計算機	14,172	3.1 %	9,213	3.6 %	4,959	53.8 %
<b>銷售收入總額</b>	<b>451,484</b>	<b>100.0 %</b>	<b>252,981</b>	<b>100.0 %</b>	<b>198,503</b>	<b>78.5 %</b>

- 本季度電子消費品作為我們的第一大終端市場，貢獻銷售收入 2.807 億美元，占銷售收入總額的 62.2%，同比增長 77.0%，主要得益於其他電源管理、超級結、MCU、NOR flash、邏輯及通用 MOSFET 產品的需求增加。
- 本季度工業及汽車產品銷售收入 9,020 萬美元，同比增長 79.1%，主要得益於 IGBT、MCU，及智能卡芯片的需求增加。
- 本季度通訊產品銷售收入 6,640 萬美元，同比增長 90.7%，主要得益於 CIS 和智能卡芯片的需求增加。
- 本季度計算機產品銷售收入 1,420 萬美元，同比增長 53.8%，主要得益於 MCU 及通用 MOSFET 產品的需求增加。

### 產能<sup>8</sup>及產能利用率

晶圓廠(仟片晶圓每月)	二零二一年 第三季度 (未經審核)	二零二零年 第三季度 (未經審核)	二零二一年 第二季度 (未經審核)
1 號晶圓廠 (200mm)	65	65	65
2 號晶圓廠 (200mm)	60	60	60
3 號晶圓廠 (200mm)	53	53	53
7 號晶圓廠 (300mm)	53	14	40
<b>合計折合 8 吋產能</b>	<b>297</b>	<b>210</b>	<b>268</b>
產能利用率 (200mm)	112.3%	102.0%	112.1%
產能利用率 (300mm)	108.7%	56.4%	104.1%
總體產能利用率	110.9%	95.8%	109.5%

- 本季度末月產能達 297,000 片 8 吋等值晶圓。總體產能利用率為 110.9%，環比上升 1.4 個百分點。

<sup>8</sup> 期末月產能，且為比較目的，以 30 天作為計算基礎。

### 付運晶圓

折合 8 吋矽片晶圓	二零二一年	二零二零年	二零二一年	同比	環比
	第三季度 (未經審核)	第三季度 (未經審核)	第二季度 (未經審核)		
付運晶圓	907	577	730	57.2 %	24.2 %

- 本季度付運晶圓 907,000 片，同比增加 57.2%，環比增加 24.2%。

### 經營開支分析

以千美元計	二零二一年	二零二零年	二零二一年	同比	環比
	第三季度 (未經審核)	第三季度 (未經審核)	第二季度 (未經審核)		
銷售及分銷費用	2,907	1,612	1,988	80.3 %	46.2 %
管理費用 <sup>9</sup>	69,413	72,588	43,917	(4.4)%	58.1 %
<b>經營開支</b>	<b>72,320</b>	<b>74,200</b>	<b>45,905</b>	<b>(2.5)%</b>	<b>57.5 %</b>

- 經營開支 7,230 萬美元，同比下降 2.5%。經營開支環比上升 57.5%，主要由於人員開支增加及研發活動的政府補助減少。

### 其他收入淨額

以千美元計	二零二一年	二零二零年	二零二一年	同比	環比
	第三季度 (未經審核)	第三季度 (未經審核)	第二季度 (未經審核)		
租金收入	3,649	3,257	3,544	12.0 %	3.0 %
利息收入	3,411	2,433	3,547	40.2 %	(3.8)%
以公允價值計量且變動計入當期損益的 金融資產之公允價值變動收益	-	225	-	(100.0)%	-
匯兌(損失)/收益	(3,456)	3,224	6,050	(207.2)%	(157.1)%
分佔聯營公司溢利	1,393	5,998	1,424	(76.8)%	(2.2)%
財務費用	(3,175)	(579)	(3,418)	448.4 %	(7.1)%
政府補貼	5,542	9,217	376	(39.9)%	1,373.9 %
其他	122	281	373	(56.6)%	(67.3)%
<b>其他收入淨額</b>	<b>7,486</b>	<b>24,056</b>	<b>11,896</b>	<b>(68.9)%</b>	<b>(37.1)%</b>

- 其他收入淨額 750 萬美元，同比下降 68.9%，主要由於本季度為外幣匯兌損失，而上年同期為外幣匯兌收益，分佔聯營公司溢利、政府補貼減少，及財務費用增加所致，環比下降 37.1%，主要由於本季度為外幣匯兌損失而上季度為外幣匯兌收益，部分被政府補貼增加所抵消。

<sup>9</sup>管理費用包括確認為研發開支抵減項目的政府補助。

### 現金流量分析

以千美元計	二零二一年 第三季度 (未經審核)	二零二零年 第三季度 (未經審核)	二零二一年 第二季度 (未經審核)	同比	環比
經營活動所得現金流量淨額	151,709	89,410	99,127	69.7 %	53.0 %
投資活動所用現金流量淨額	(263,768)	(315,355)	(134,719)	(16.4)%	95.8 %
融資活動所得現金流量淨額	584,941	222,096	40,584	163.4 %	1,341.3 %
外匯匯率變動影響淨額	(3,057)	21,351	8,024	(114.3)%	(138.1)%
<b>現金及現金等價物變動影響淨額</b>	<b>469,825</b>	<b>17,502</b>	<b>13,016</b>	<b>2,584.4 %</b>	<b>3,509.6 %</b>

- 本季度經營活動所得現金流量淨額 1.517 億美元，同比上升 69.7%，主要得益於客戶回款強勁，部分被材料和人工費用的支出增加，及收到增值稅退稅款減少所抵消。
- 投資活動所用現金流量淨額 2.638 億美元，其中固定資產及無形資產投資支出 2.528 億美元，權益工具投資 630 萬美元，和投資一家聯營公司 590 萬美元，部分被利息收入 120 萬美元所抵消。
- 融資活動所得現金流量淨額 5.849 億美元，其中提取銀行借款 6.050 億美元和發行股份收到 30 萬美元，部分被償還銀行貸款本金 1,940 萬美元，租賃負債支出 70 萬美元及支付銀行借款利息 30 萬美元所抵消。

### 資本結構

以千美元計	於九月三十日 二零二一年 (未經審核)	於六月三十日 二零二一年 (未經審核)
資產總額	5,874,595	4,990,981
負債總額	2,388,955	1,539,407
所有者權益總額	3,485,640	3,451,574
資產負債率 <sup>10</sup>	40.7%	30.8%

### 資本開支

以千美元計	二零二一年 第三季度 (未經審核)	二零二一年 第二季度 (未經審核)
華虹 8 吋	28,243	17,439
華虹無錫	224,540	119,096
<b>合計</b>	<b>252,783</b>	<b>136,535</b>

- 本季度資本開支 2.528 億美元，其中 2.245 億美元用於華虹無錫。

<sup>10</sup>資產負債率=負債總額/資產總額。

## 流動性分析

以千美元計	於九月三十日 二零二一年 (未經審核)	於六月三十日 二零二一年 (未經審核)
發展中物業	107,830	107,865
存貨	395,788	355,881
貿易應收款項及應收票據	159,026	108,358
預付款項、其他應收款項及其他資產	54,463	61,448
應收關聯方款項	6,987	6,253
已凍結存款及定期存款	361	362
現金及現金等價物	1,444,347	974,522
<b>流動資產總額</b>	<b>2,168,802</b>	<b>1,614,689</b>
貿易應付款項	159,025	147,074
其他應付款項及暫估費用	683,763	491,089
計息銀行借款	181,341	138,627
租賃負債	1,794	2,010
政府補助	119,456	76,611
應付關聯方款項	12,007	18,723
應付所得稅	34,577	22,165
<b>流動負債總額</b>	<b>1,191,963</b>	<b>896,299</b>
<b>淨營運資金</b>	<b>976,839</b>	<b>718,390</b>
速動比率	1.5x	1.4x
流動比率	1.8x	1.8x
貿易應收款項及應收票據周轉天數	27	31
存貨周轉天數	103	111

- 貿易應收款項及應收票據由上季度末的 1.084 億美元上升至本季度末的 1.590 億美元，主要由於銷售收入上升。
- 預付款項、其他應收款項及其他資產由上季度末的 6,140 萬美元下降至本季度末的 5,450 萬美元，主要由於應收增值稅退稅款減少。
- 其他應付款項及暫估費用由上季度末的 4.911 億美元上升至本季度末的 6.838 億美元，主要由於應付資本性開支及客戶預收款項增加。
- 計息銀行借款由上季度末的 1.386 億美元上升至本季度末的 1.813 億美元，主要由於本季度提取銀行借款。
- 政府補助由上季度末的 7,660 萬美元上升至本季度末的 1.195 億美元，主要由於收到政府補助。
- 應付所得稅由上季度末的 2,220 萬美元上升至本季度末的 3,460 萬美元，主要由於計提本季度所得稅開支。
- 淨營運資金本季度末 9.768 億美元，流動比率 1.8。
- 貿易應收款項及應收票據周轉天數由上季度的 31 天縮短至 27 天。
- 存貨周轉天數 103 天。

上述公佈詳情請參閱華虹半導體網站 [www.huahonggrace.com](http://www.huahonggrace.com)。

華虹半導體有限公司  
簡明損益表(以千美元計,每股盈利和股數除外)

	截至以下日期止三個月		
	於九月三十日 二零二一年 (未經審核)	於九月三十日 二零二零年 (未經審核)	於六月三十日 二零二一年 (未經審核)
銷售收入	451,484	252,981	346,110
銷售成本	(329,231)	(191,689)	(260,440)
<b>毛利</b>	<b>122,253</b>	<b>61,292</b>	<b>85,670</b>
其他收入及收益	12,791	18,641	13,898
銷售及分銷費用	(2,907)	(1,612)	(1,988)
管理費用	(69,413)	(72,588)	(43,917)
其他費用	(3,523)	(4)	(8)
財務費用	(3,175)	(579)	(3,418)
分佔聯營公司溢利	1,393	5,998	1,424
<b>稅前溢利</b>	<b>57,419</b>	<b>11,148</b>	<b>51,661</b>
所得稅開支	(21,801)	(10,046)	(14,483)
<b>期內溢利</b>	<b>35,618</b>	<b>1,102</b>	<b>37,178</b>
以下各方應佔利潤			
母公司擁有人	50,807	17,694	44,082
非控股權益	(15,189)	(16,592)	(6,904)
持有人應佔每股盈利			
基本	0.039	0.014	0.034
攤薄	0.038	0.013	0.033
<b>用於計算持有人應佔每股基本盈利的期內已發行普通股加權平均數</b>	<b>1,300,378,175</b>	<b>1,294,890,812</b>	<b>1,300,192,217</b>
<b>用於計算持有人應佔每股攤薄盈利的期內已發行普通股加權平均數</b>	<b>1,324,812,751</b>	<b>1,317,522,812</b>	<b>1,325,014,217</b>

華虹半導體有限公司  
簡明綜合財務狀況表(以千美元計)

	截至		
	於九月三十日 二零二一年 (未經審核)	於六月三十日 二零二一年 (未經審核)	於九月三十日 二零二零年 (未經審核)
<b>資產</b>			
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備	3,026,016	2,710,002	2,272,520
投資物業	181,576	182,287	172,727
使用權資產	75,334	76,997	77,323
無形資產	33,640	35,784	33,603
於聯營公司的投資	117,579	110,699	88,494
以公允價值計量且變動計入其他綜合收益的權益工具	250,395	232,575	212,754
長期預付款項	10,429	17,407	33,445
應收關聯方款項	-	40	180
遞延稅項資產	10,824	10,501	9,108
<b>非流動資產總額</b>	<b>3,705,793</b>	<b>3,376,292</b>	<b>2,900,154</b>
<b>流動資產</b>			
發展中物業	107,830	107,865	-
存貨	395,788	355,881	205,223
貿易應收款項及應收票據	159,026	108,358	122,938
預付款項、其他應收款項及其他資產	54,463	61,448	66,261
應收關聯方款項	6,987	6,253	11,292
已凍結存款及定期存款	361	362	345
現金及現金等價物	1,444,347	974,522	716,459
<b>流動資產總額</b>	<b>2,168,802</b>	<b>1,614,689</b>	<b>1,122,518</b>
<b>流動負債</b>			
貿易應付款項	159,025	147,074	96,232
其他應付款項及暫估費用	683,763	491,089	386,672
計息銀行借款	181,341	138,627	223,844
租賃負債	1,794	2,010	3,513
政府補助	119,456	76,611	59,076
應付關聯方款項	12,007	18,723	12,790
應付所得稅	34,577	22,165	21,350
<b>流動負債總額</b>	<b>1,191,963</b>	<b>896,299</b>	<b>803,477</b>
<b>流動資產淨額</b>	<b>976,839</b>	<b>718,390</b>	<b>319,041</b>
<b>總資產減流動負債</b>	<b>4,682,632</b>	<b>4,094,682</b>	<b>3,219,195</b>
<b>非流動負債</b>			
計息銀行借款	1,158,994	616,254	19,823
租賃負債	16,131	16,463	17,311
遞延稅項負債	21,867	10,391	7,351
<b>非流動負債總額</b>	<b>1,196,992</b>	<b>643,108</b>	<b>44,485</b>
<b>淨資產</b>	<b>3,485,640</b>	<b>3,451,574</b>	<b>3,174,710</b>
<b>權益和負債權益</b>			
股本	1,984,658	1,984,207	1,974,417
儲備	704,114	652,280	394,214
<b>本公司擁有人應佔權益</b>	<b>2,688,772</b>	<b>2,636,487</b>	<b>2,368,631</b>
非控股權益	796,868	815,087	806,079
<b>權益總額</b>	<b>3,485,640</b>	<b>3,451,574</b>	<b>3,174,710</b>

華虹半導體有限公司  
簡明綜合現金流量表(以千美元計)

	截至以下日期止三個月		
	於九月三十日 二零二一年 (未經審核)	於九月三十日 二零二零年 (未經審核)	於六月三十日 二零二一年 (未經審核)
<b>經營活動所得現金流量：</b>			
稅前溢利	57,419	11,148	51,661
折舊及攤銷	87,955	56,791	78,786
應佔聯營公司溢利	(1,393)	(5,998)	(1,424)
營運資金的變動及其它	7,728	27,469	(29,896)
<b>經營活動所得現金流量淨額</b>	<b>151,709</b>	<b>89,410</b>	<b>99,127</b>
<b>投資活動所用現金流量：</b>			
購買物業、廠房、設備及無形資產項目	(252,783)	(403,586)	(136,535)
投資聯營公司	(5,921)	-	-
投資權益工具	(6,290)	-	-
其他投資活動所得現金流量	1,226	88,231	1,816
<b>投資活動所用現金流量淨額</b>	<b>(263,768)</b>	<b>(315,355)</b>	<b>(134,719)</b>
<b>融資活動所得現金流量：</b>			
提取銀行貸款	604,986	219,439	47,590
發行股份所得收益	360	3,741	151
償還銀行貸款	(19,439)	-	(2,322)
償還租賃負債	(710)	(1,009)	(827)
已付利息	(256)	(75)	(4,008)
<b>融資活動所得現金流量淨額</b>	<b>584,941</b>	<b>222,096</b>	<b>40,584</b>
現金及現金等價物增加/(減少)淨額	472,882	(3,849)	4,992
外匯匯率變動影響淨額	(3,057)	21,351	8,024
期初現金及現金等價物	974,522	698,957	961,506
<b>期末現金及現金等價物</b>	<b>1,444,347</b>	<b>716,459</b>	<b>974,522</b>

於本公告日期，本公司董事分別為：

**執行董事**

張素心(董事長)

唐均君(總裁)

**非執行董事**

孫國棟

王靖

葉峻

**獨立非執行董事**

張祖同

王桂壩太平紳士

葉龍蜚

**承董事會命**

華虹半導體有限公司

張素心

董事長兼執行董事

中國 香港

二零二一年十一月十一日